

半导体晶圆激光切割碳化硅激光打孔精密刻槽支持定制

产品名称	半导体晶圆激光切割碳化硅激光打孔精密刻槽支持定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

激光切割机在半导体晶片上的应用

半导体器件分类

激光属于非接触加工，不会对晶圆产生机械应力，对晶圆的损伤较小。由于激光聚焦的优势，聚焦点可以小到亚微米量级，更有利于晶圆的微加工，可以加工小零件。即使在低脉冲能量水平下，也可以获得高能量密度，并且可以有效地处理材料。大多数材料通过吸收激光直接蒸发材料，并冲出连续的盲孔形成通道。从而达到切割的目的，因为导光板小，碳化影响*低。

切割过程

半导体晶圆激光隐形切割技术是一种全新的激光切割工艺，具有切割速度快、切割、时不产生粉尘、不损耗、要求、切割路径小、完全干法等诸多优点。隐形切割的主要原理是通过材料表面将短脉冲激光束聚焦在材料中间，然后通过外压将切屑分离

华诺激光依托先进激光技术，致力于激光精密切割打孔,焊接加工研发和代工服务的高科技企业。拥有一支经验丰富的技术开发和管理团队，以及超过20台的包括紫外激光器，超快激光器，光纤激光器，二氧化碳激光器等先进进口激光源，以及配套的加工平台，并且还拥有3D显微镜，激光干涉仪，红外热成像仪，二次元等检测和分析工具。公司专注于各种尺寸的N型、P型、方片以及双抛硅片、单晶硅、多晶硅、镀膜硅片、二氧化硅的激光精密切割、狭缝切割、异型切割、微孔小孔等激光精密加工。